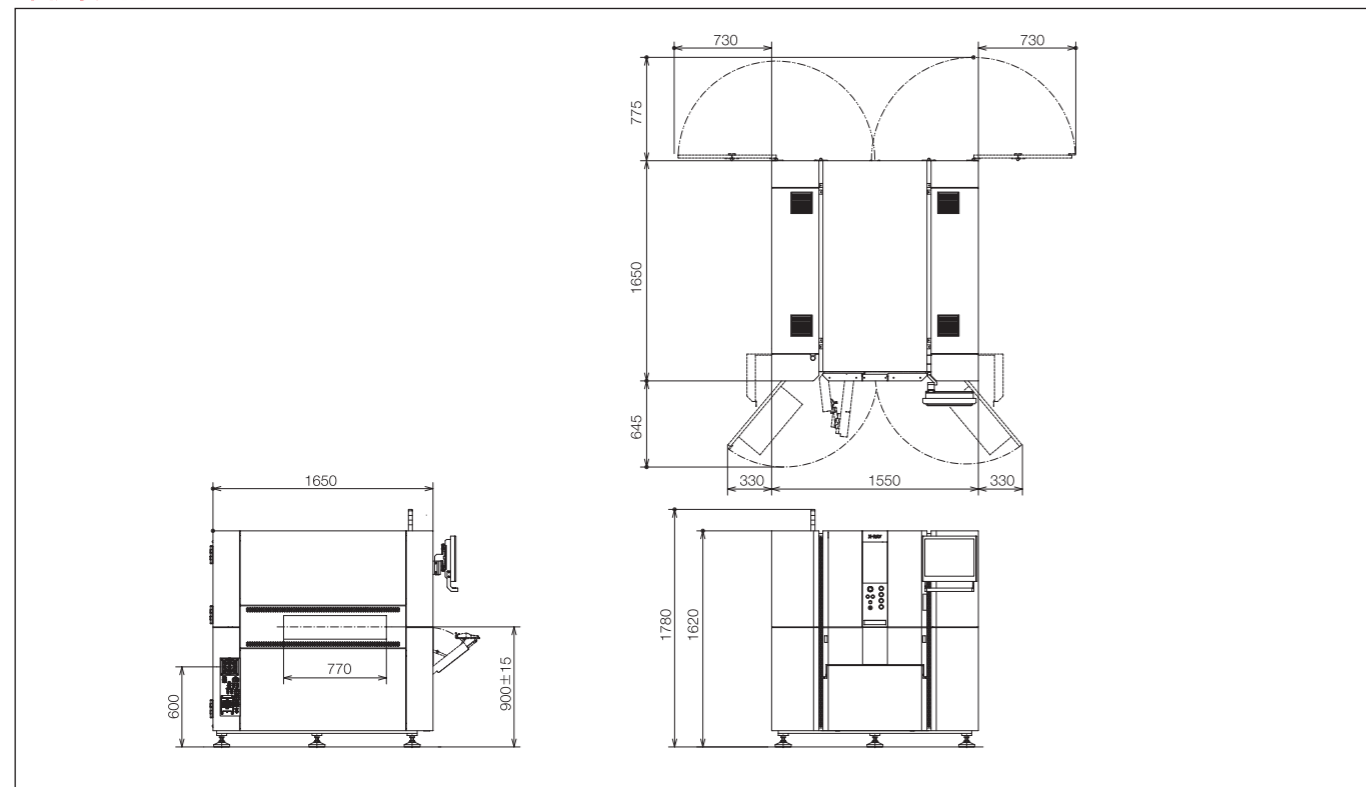


## 概要仕様

### ■ハード構成 / 機能仕様

項目	内容
形式	VT-X700-M
X線源	密閉型マイクロフォーカス
検出器	フラットパネル型
装置外形寸法	1,550×1,650×1,620mm
基板挿入口高さ	約900mm
装置重量	約2,850kg
対応基板サイズ	50×50~333×255mm
対応基板重量	2.0Kg以下
基板厚	0.4~3.0mm
基板そり	±2.0mm
部品高さ(クリアランス)	上面…50mm 下面…20mm
分解能(X/Y)	10, 15, 20, 25 $\mu$ m (検査対象により選択)
照射角度( $\theta_n$ )	45°
電源電圧	200, 220, 230, 240V
消費電力	8kVA
検査対象部品	BGA/CSP

## 外形寸法図



本誌には主に機種のご選定に必要な内容を掲載し、ご使用上の注意事項等は掲載しておりません。  
 ご使用上の注意事項等、ご使用の際に必要な内容につきましては、必ずユーザーズマニュアルをお読みください。  
 本誌に記載されているアプリケーション事例は参考用ですので、ご採用に際しては機器・装置の機能や安全性をご確認の上、ご使用ください。  
 本誌に記載のない条件や環境での使用、および原子力制御・鉄道・航空・車両・燃焼装置・医療機器・娯楽機械・安全機器、その他人命や財産に大きな影響が予測されるなど、特に安全性が要求される用途への使用をご検討の場合は、定格・性能に対し余裕を持った使い方やフェールセーフ等の安全対策へのご配慮をいたぐとともに、当社営業担当者までご相談いただき仕様書等による確認をお願いします。

## オムロン株式会社

### インダストリアルオートメーションビジネスカンパニー 検査システム事業部

〒141-0032 東京都品川区大崎1-11-1  
ゲートシティ大崎ウエストタワー14F

ビジョンシステム販売部 東部販売課(東京) / 03-3779-9046  
 中部販売課(名古屋) / 052-561-0156  
 西部販売課(大阪) / 06-6347-5840

修理・保守・サービスのお問い合わせ  
 AOIサービスセンター / 0120-066-394

### OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION (CHINA) CO., LTD.

RM2211, Bank Of China Tower  
 No.200 Yin Cheng Road(M),  
 Shanghai China 200120  
 TEL:+86-21-50372522 FAX:+86-21-50372244

### OMRON ELECTRONICS LTD.

Opal drive, Fox Milne, Milton Keynes  
 MK15 0DG, UK  
 TEL:+44-1908-258258 FAX:+44-1908-258158

### OMRON ELECTRONICS LLC

1 East Commerce Drive, Schaumburg,  
 Illinois, 60173-5302 U.S.A.  
 TEL:+1-847-843-7900 FAX:+1-847-843-7787

### OMRON ELECTRONICS KOREA CO., LTD.

2F, Young Poong Bldg., 142, Nonhyeon-Dong,  
 Gangnam-Gu, Seoul, 135-749, Korea  
 TEL:+82-2519-3977 FAX:+82-2519-3976

### OMRON ASIA PACIFIC PTE. LTD.

438A ALEXANDRA ROAD, #05-05/08  
 ALEXANDRA TECHNOPARK,  
 SINGAPORE 119967  
 TEL:+65-6835-3011 FAX:+65-6547-6766

NEW

## 高速X線CT型自動検査装置

形VT-X700

OMRON

進化するものづくりに、透視する力を。

# VT-X700



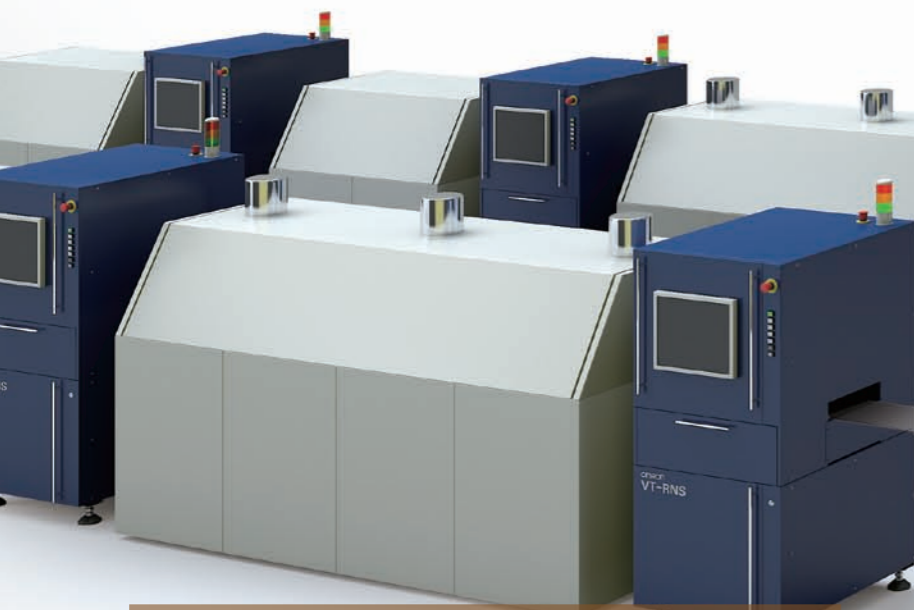
realizing  
 つくることの、すべてに。

# BGA部品をはじめ、下面電極部品のはんだを検査。X線CTだから接合面に強い。

## Needs

信頼性・生産性・使いやすさ。  
これからの製造ラインに求められる課題です。

日々高度化する生産環境。しかし、従来のX線透過型検査手法では、BGA部品をはじめ、下面電極部品の接合面などの検査は、見過ぎ(良品の不良判定)や、不良品の見逃しなどが多く、自動検査が困難でした。品質保証や生産効率の向上が、より強く求められるこれからの時代には、現場ニーズに対応した完全自動の検査装置が求められています。



表面実装の品質検査に求められる課題

### 信頼性

#### 安定した判断基準

製品の信頼性は、明確な検査基準の検査で得られます。  
不良品の的確な良否判定性能が求められます。

### 生産性

#### 生産タクトに影響しない高速検査

品質向上と生産効率という反発しがちな課題をクリアし、  
生産タクトに影響しない高速検査が求められています。

### 使いやすさ

#### 誰にでも扱える操作性

下面電極部品の接合面など、従来型検査では困難だった部分を  
手軽に自動検査する必要性が、日々高まっています。

## Innovation

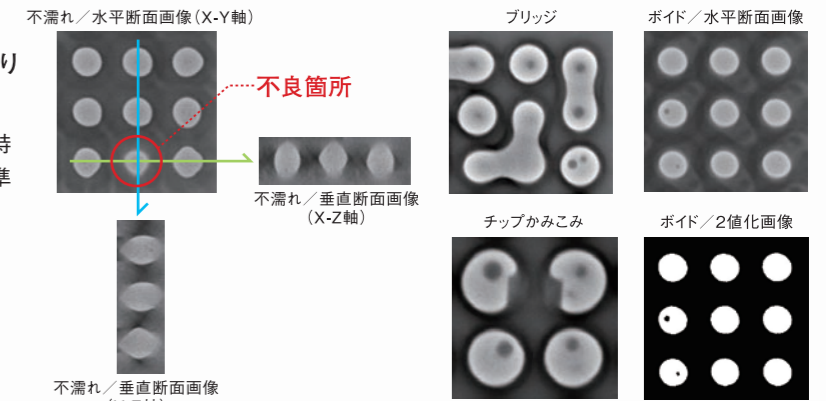
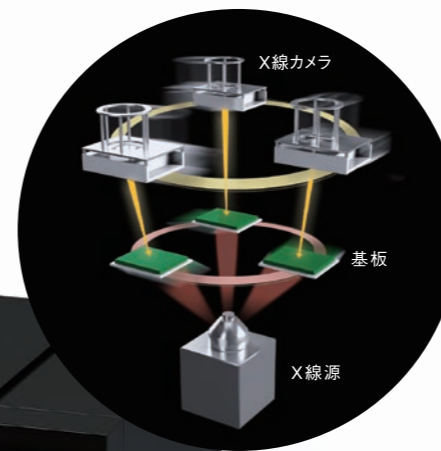
課題を解決する  
オムロンの3つのイノベーション

信頼性・生産性・使いやすさの課題に、  
VT-X700は、CT撮像による3次元判定で対応。  
自動検査アルゴリズムによる自動検査や、インライン検査に対応した  
高性能、使いやすいGUIという3つのイノベーションで、  
良否判定の難しかった部品検査を大きく効率化します。

### 1 高精度X線CT撮像を採用

3次元斜めCT撮像と検査アルゴリズムの構築により  
高速高精度な自動検査を可能に。

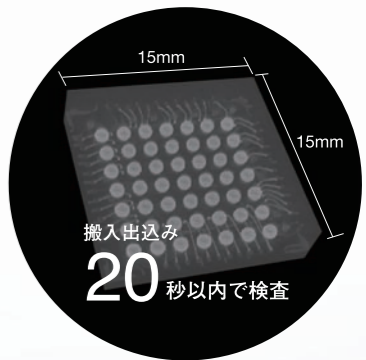
CT撮像+検査アルゴリズムによって、検査断面の分離・特定まで踏み込んだ細やかな検査基準を作成可能。良否基準が明確になった生産環境で、見過ぎや見逃しを解消します。



### 2 SMT業界最速クラス

効率的X線検査手法の確立で  
高速検査を実現

インライン検査を実現するために、高速性能を重視。15mm×15mmのBGA部品で  
20秒という高速性能で、生産タクトに影響しないインライン完全自動検査を実現しました。

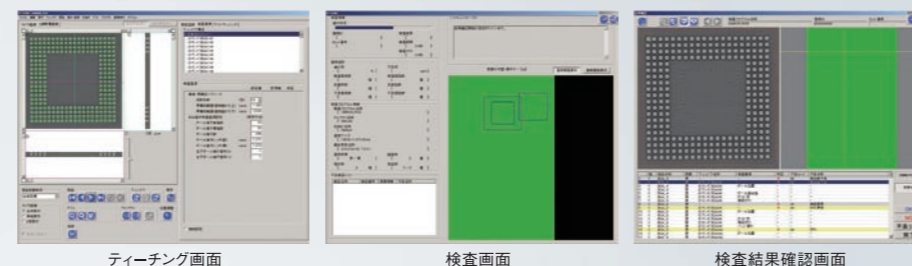


※目視は一般的な作業によるタクトです。検査項目は未接合、未熔融等

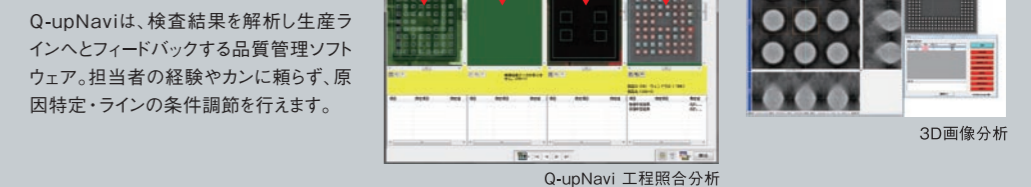
### 3 わかりやすいGUIで全数検査を視覚化

部品の見えない部分の良否判定もカンタン操作

BGA部品の接合部など、見えない部分の検査結果の確認や  
判定基準の設定なども、実績あるGUIでわかりやすく確認・設定・操作。すぐに活用いただけます。



Q-upNaviで検査から原因把握、対策まで  
工程改善をトータルに支援



Q-UpNaviのX線検査運用部分及び一部の検査ログに関しては、アイシン・エイ・ダブリュ(株)様と共同開発を行っております。